

晋江市人民政府文件

晋政规〔2025〕9号

晋江市人民政府关于 印发晋江市进一步培育集成电路 全产业链的若干措施（2025年修订版）的通知

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委会，市有关单位：

《晋江市进一步培育集成电路全产业链的若干措施（2025年修订版）》已经十四届市委常委会第150次（扩大）会议和市政府第68次常务会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

晋江市人民政府

2025年6月26日

（此件主动公开）

晋江市进一步培育集成电路全产业链的若干措施（2025 年修订版）

为贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神、习近平总书记来闽重要讲话精神，推动产业创新与科技创新深度融合，加快融入海峡两岸集成电路产业合作试验区，推动我市以集成电路为核心的新一代信息技术与人工智能产业高质量跃升发展，加速打造具有全国影响的千亿产业集群，特制定本措施。

一、支持方向

为营造我市集成电路产业发展的良好生态，重点支持和鼓励落地晋江的集成电路全链条业态的企业、项目、机构、人才入驻，包括集成电路设计、制造、封测、装备、材料以及应用终端、创新平台、服务配套等。

二、招商扶持政策

（一）针对新引进的集成电路企业：

1. 3 年内总投资超 1 亿元的集成电路生产性及配套项目，按其 3 年内新购置生产设备金额的 10% 给予补助，单个企业累计最高 3000 万元；（责任单位：集成电路筹备组）

2. 3 年内总投资超 2000 万元的集成电路设计项目，按实际到资额的 10% 予以补助，单个企业累计最高 500 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（二）对新引进的集成电路产业链企业，采取事前备案、先缴后补的方式给予场地租金补助，补助标准不超过企业实际支付的租金标准。补助标准如下：

1. 生产性及配套企业：对租用生产场地的，前三年按实际租金的 100%给予补助，第四、第五年按实际租金的 50%给予补助。以上租金补助面积累计最高 1500 平方米。（责任单位：集成电路筹备组）

2. 设计类企业：对租用研发、办公场地的，前三年按实际租金的 100%给予补助，第四、第五年按实际租金的 50%给予补助。以上租金补助面积累计最高 500 平方米。（责任单位：集成电路筹备组）

（三）对新增用地或者租用厂房面积不少于 500 平方米的新建集成电路生产性及配套项目，需租用临时办公场所的，采取事前备案、先缴后补的方式给予租金补助，补助标准最高 30 元/平方米，补助面积最高 100 平方米，补助时间最长 12 个月。补助标准不超过企业实际支付的租金标准。（责任单位：集成电路筹备组）

（四）对新引进的集成电路生产性及配套企业的万级无尘车间按 600 元/平方米、千级无尘车间按 1000 元/平方米、百级及以上等级无尘车间按 2500 元/平方米给予装修补助，单个企业最高补助 500 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（五）对新投产的集成电路企业与非关联企业之间首次形成

集成电路产品或服务供应的，按照首次形成供应 12 个月内实际购销金额的 10%给予最高 300 万元补贴（供需双方各 5%），单个企业年度最高奖励 800 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

三、投融资激励政策

（一）鼓励基金投资，基金对集成电路企业进行风险投资或天使投资且投资期限一年以上的（投资机构需经注册备案），按照投资机构实际到位投资总额的 10%给予该基金一次性奖励，单个项目最高奖励 100 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（二）对于新投产的集成电路企业，投产 5 年内获得的银行贷款，分别按银行同期基准利率的 30%、50%给予生产性企业、设计企业贴息支持，获得贷款利率为基准下浮的企业以实际贷款利率的 30%、50%给予生产性企业、设计企业贴息支持，单个企业每年最高 200 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

四、科研鼓励政策

（一）支持集成电路设计企业、高校及科研院所发展：

1. 对开展多项目晶圆（MPW）流片的集成电路企业，按 MPW 直接费用的 80%给予补助，对采用全掩膜工程产品流片的，按照其每款产品首次工程流片费用（掩膜版费及流片加工费）的 30%给予补助，单个企业年度最高补助 400 万元；对利用经认可的集成电路生产线流片的企业，按首次工程流片费用（含 IP 授权或购置费、掩膜版费及流片加工费等）的 40%给予补助，单个企业年度最高补助 500 万元；（责任单位：集成电路筹备组）

2. 对高校或科研院所开展MPW流片的，按MPW直接费用的 90%给予补助，开展全掩膜工程产品流片的，参照集成电路企业标准给予补助，单个高校或科研院所最高补助 400 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（二）对购买IP开展高端芯片研发、先进或特色工艺芯片研发的集成电路企业，按IP购买直接费用的 50%给予补助，单个企业年度最高补助 250 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（三）对晶圆进行功能性、可靠性、兼容性测试（含中测、成测）、失效分析、封装验证的新引进集成电路设计企业，按实际支付费用给予不超过 30%补助，单个企业年度最高补助 100 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

五、人才优待政策

（一）经认定的集成电路优秀人才（以下简称“优秀人才”）按第一至第七层次发放工作津贴或交通补贴，工作津贴分别为 15000、12000、8000、5000、3000、1000、500 元/人·月，交通补贴分别为 15000、13000、11000、9000、6000、3000、1000 元/人·次。（责任单位：集成电路筹备组）

（二）集成电路产业优秀人才经我市申报并成功入选以下重大专项的，按以下比例给予配套经费资助，各项配套经费资助累计不超过 400 万元。

1. 入选国家重点联系专家、国家万人计划的，按国家资助额度 1:1 的比例给予配套经费资助；（责任单位：市委组织部）

2. 入选福建省引进高层次人才“百人计划”、福建省引进台湾高层次人才“百人计划”、福建省特级后备人才、产业领军团队人才、“雏鹰计划”青年拔尖人才、“创业之星”“创新之星”人才等，按福建省级资助额度 1:0.5 的比例给予配套经费资助。（责任单位：市委组织部）

（三）第一至第五层次优秀人才，可申请租购超高端人才社区（限第一至第四层次人才）或高端人才社区人才房，在优惠面积内享受房租补助和购房补助。第一至第五层次人才最高优惠面积分别为 300 平方米、250 平方米、200 平方米、150 平方米、100 平方米。房租补助按合同租金的 50% 发放。为企业服务满 5 年（时间可累计）且承租满 5 年的，根据个人意愿可申请购买所租住房，按购房时房产评估价的 40% 与 5 年个人支付房租之和给予购房补助。

在我市其他社区购置商品房的，第一至第七层次分别按 100 万元、60 万元、30 万元、20 万元、15 万元、10 万元、5 万元给予购房补贴，分三年兑现。购房补贴与上述人才房政策不重复享受。（责任单位：集成电路筹备组）

（四）根据调查摸底情况，积极妥善安排优秀人才子女入学；优秀人才的子女就读我市国际（双语）学校的，第一至第四层次按实缴学杂费的 30% 补助，第五至第七层次分别按实缴学杂费的 20%、15%、10% 补助。（责任单位：集成电路筹备组、市教育局）

（五）优秀人才在我市公立医院就医，可享受先诊疗后付费特别服务；已参加医疗保险的，在扣除医疗保险报销部分后按30%补助，第一至第七层次优秀人才年度最高补助分别为25万元、20万元、15万元、10万元、5万元、3万元、1万元。（责任单位：集成电路筹备组、泉州市医疗保障局晋江分局、市卫健局）

（六）我市新投产的规模以上集成电路企业，可推荐一名担任企业副总经理以上职务或主要科研项目第一负责人的对象作为第三至第五层次优秀人才。（责任单位：集成电路筹备组）

六、附则

（一）除特别规定外，同一企业（或个人）获多层级认定或奖励的，按最高等次享受本级政策，获同级别多次认定或奖励的不予重复享受；同一企业（或个人）符合我市多项政策条款或性质相似条款的，按最高标准奖励。通过已享受设备补助或装修补贴的设备或无尘车间进行贷款的，不再享受贴息支持。已享受该政策相关条款的，不再享受“一企一议”同类型奖励或补助。

（二）本意见所指投资额均不含政府的补助或奖励；新引进集成电路企业指本意见生效后签订项目投资协议的企业。

（三）优秀人才任期满3年后，于第4年开展人才中期评估。对评估合格的对象，可以继续享受各项人才政策；对于评估不合格的对象，终止享受各项人才政策。

（四）园区企业若在安全生产方面受到相关部门处罚，或存在严重失信、涉黑涉恶情形的，则当年度享受政策方面予以“一票否决”。

（五）其他半导体领域企业参照本意见执行。

（六）本措施自 2025 年 7 月 26 日起正式实施，至 2026 年 12 月 31 日止。2025 年 1 月 30 日起至公布之日期间参照执行，《晋江市人民政府关于进一步加快培育集成电路全产业链的若干意见》（晋政文〔2022〕15 号）同步废止。

（七）本意见由泉州半导体高新技术产业园区管委会晋江分园区办事处负责解释并制定具体操作程序。

- 附件：1. 集成电路产业重点鼓励业态目录
2. 晋江市集成电路产业优秀人才认定标准
3. 晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定办法

附件 1

集成电路产业重点鼓励业态目录

一、集成电路设计与制造

(一) 数字IC设计与制造: 中央处理器 (CPU)、微处理器 (MPU)、张量处理器 (TPU)、神经网络处理器 (NPU)、图形处理器 (GPU)、微控制器 (MCU)、数字信号处理器 (DSP)、易失性存储器 (DRAM、SRAM)、非易失性存储器 (NOR Flash、NAND Flash、MRAM、SCM)、专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其它数字集成电路

(二) 模拟IC设计与制造: 电源管理芯片 (稳压器、开关电源、电池管理等)、信号链芯片 (放大器、滤波器、接口、射频、微波等)、时钟与计时芯片及其它模拟集成电路

(三) 其它芯片设计与制造: 模数/数模转换器 (ADC/DAC)、传感器芯片、物联网芯片、面板驱动芯片、触控芯片、蜂窝通信芯片、无线局域网芯片、蓝牙芯片、卫星通信芯片、AI芯片、MEMS芯片、编解码芯片、高端内存芯片 (HBM、HMC、3D X-AI 等)、功率芯片及器件 (碳化硅、氮化镓、氧化镓等)、硅光芯片、光电芯片器件等

二、集成电路封装与测试

(一) 传统封装: 双列直插式封装 (DIP)、小外形封装 (SOP)、四侧引脚扁平封装 (QFP)、方形扁平无引脚封装

(QFN)、球栅阵列封装(BGA)、针栅阵列封装(PGA)、芯片尺寸封装(CSP)等

(二) 先进封装: 倒装芯片封装(Flip Chip)、晶圆级封装(WLP)、系统级封装(SiP)、2.5D封装、3D封装以及其它先进封装

(三) 测试相关: 设计验证测试(DVT)、生产验证测试(PVT)、晶圆测试(CP)、成品测试(FT)、可靠性测试(Reliability Test)以及其它第三方测试实验室提供的测试服务

三、集成电路装备与零部件

(一) 制造设备: 光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、离子注入机、清洗设备、扩散设备、涂胶显影设备、切割机、CMP设备、去胶机等集成电路制造设备及零部件

(二) 封装设备: 减薄机、划片机、固晶机、点胶机、键合机、塑封机、电镀机、薄膜沉积设备、涂胶显影设备、光刻机、刻蚀机等集成电路封装设备及零部件

(三) 量检测设备: 光学散射仪(OCD)、椭圆偏振仪、探针显微镜、扫描/透射电镜、X射线量测系统、缺陷检测设备、探针台、分选机、测试机等集成电路量检测设备及零部件

(四) 其它集成电路相关设备及零部件

四、集成电路材料

(一) 制造材料: 硅片、掩膜版及掩膜版基材、电子特气、抛光材料、高纯度化学试剂、光刻胶及配套试剂、靶材、支撑

环等

（二）封装材料：PCB板、封装基板、塑封料、引线框架、键合丝、粘合材料、Tray盘等

（三）其它集成电路相关材料

五、集成电路配套服务

（一）设计配套服务：电子设计自动化（EDA）工具服务、IP核授权服务、设计咨询服务、设计验证服务等

（二）生产配套服务：设备租赁和交易服务、设备维修与升级服务、材料供应服务、物流及仓储服务等

（三）其它集成电路配套服务

六、集成电路终端应用

（一）智能穿戴：智能鞋服、VR/AR设备、智能眼镜、智能手环、手表等

（二）智能家居：智能安防、智能插座、智能门锁、智能摄像头、智能网关、智能照明、智能烟雾探测预警器、家用智能投影仪、扫地机器人、扫拖一体机、智能家居系统等

（三）汽车电子：各类车规传感器、摄像头、显示屏等汽车电子关键零部件，热管理系统、电驱系统、域控制器、车用线束、车用连接器等电动化构成和基础元件，中控屏、HUD、网关模块、车载单元、TBOX、汽车音响、多媒体导航、智能后视镜、行车记录仪、车用传感系统、智能仪表盘等汽车电子终端部件

（四）电竞硬件：电脑主板、显卡、内存、硬盘、处理器等主设备，显示器、键盘、鼠标、耳麦、手柄等主流端游外设硬件，手机键盘、手柄、专用摇杆、控制器等手游外设，电竞椅、电竞鼠标垫等配套产品

（五）信创整机：服务器、台式电脑、笔记本电脑、交换机、路由器等

（六）智能手机：手机组装制造以及手机金属外壳、镜头、手机屏幕等手机元器件和零组件

（七）泛AIoT终端产品：智能收银机、智能音箱、智能学习台灯、智能投影仪、点读笔、3D打印、智能水电气表等

（八）机器人：工业机器人、家用机器人、商用机器人、特种机器人、农业机器人、物流机器人等其它应用机器人

（九）新型显示：液晶显示（LCD）、有机发光二极管（OLED、AMOLED、Micro OLED）、微发光二极管（Mini/Micro LED）、量子点发光二极管（QLED）、激光显示、电子纸、柔性显示、透明显示、3D显示、全息显示等

（十）智能光伏：光储融合、光伏制氢、逆变储能光伏系统等光储一体化产品，智能光伏系统、光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品，高效智能光伏逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件，光储、光氢一体的电力转换等关键技术装备。

附件 2

晋江市集成电路产业优秀人才认定标准

晋江市集成电路产业优秀人才分为七层次，符合下列任一条目的人才可认定为我市集成电路产业对应层次优秀人才。对于同时符合多个层次或条目的，按从高从优不重复原则确定优秀人才层次。建立专家评审机制，对于未涵盖的其他相应层次的人才，由福建省集成电路产业园区建设筹备工作组人才科技组会相关部门组织专家组或委托专业机构评定后报福建省集成电路产业园区建设筹备工作组批准可纳入相应优秀人才层次。

一、第一层次

（一）国际顶级知名奖项获得者：诺贝尔奖、中国国家最高科学技术奖、美国国家科学奖章（总统科学奖）、美国国家技术创新奖章、法国全国科研中心科研奖章、英国皇家金质奖章、科普利奖章、图灵奖、菲尔兹奖、沃尔夫奖、阿贝尔奖、克拉福德奖、日本国际奖、京都奖、邵逸夫奖；

（二）国际电气和电子工程师协会（IEEE）奖章获得者；

（三）国际电气和电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、国际计算机学会会士（ACM Fellow）、国际工程技术学会会士（IET Fellow）、美国物理学会会士（APS Fellow）；

（四）美国工程界三大最高奖项：德雷铂奖（Charles Stark Draper Prize）、拉斯奖（Fritz J. and Dolores H. Russ Prize）、戈登奖（Bernard M. Gordon Prize）获得者；

（五）中国、美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加

拿大、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、比利时、瑞士、奥地利、荷兰、西班牙、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、以色列、印度、乌克兰、新加坡、韩国等的科学院院士、工程院院士(即成员member或高级成员fellow, 见中国科学院国际合作局网站<http://www.bic.cas.cn>), 台湾中央研究院院士;

(六) 国家重点联系专家长期项目、创业人才项目、外国专家项目、顶尖人才与创新团队项目的入选者, 国家“万人计划”杰出人才、领军人才;

(七) 中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者;

(八) 中国机械工程学会科技成就奖、青年科技成就奖获得者;

(九) 中国机械工业科学技术奖特等奖前3位完成人;

(十) 近10年, 获得以下奖项之一者:

1. 国家自然科学奖、技术发明奖一等奖前3位完成人, 国家科技进步奖特等奖前5位完成人, 国家科技进步奖一等奖前3位完成人, 省科学技术奖重大贡献奖获得者;

2. 中国青年科学家奖;

3. “长江学者”称号获得者。

(十一) 近10年, 担任以下职务之一者:

1. 原国家“973计划”项目首席科学家;

2. 原国家“863计划”项目首席科学家;

3. 原国家科技支撑(攻关)计划项目负责人;

4. 国家科技重大专项专家组组长, 且项目(课题)通过验收;

5. 国家重点研发计划重点专项项目组负责人；
6. 国家级人工智能或机器人领域大赛专家组组长；
7. 国家重点学科、重点实验室、国家级企业技术中心、工程技术研究中心首席专家、国家制造业创新中心技术委员会主任，且年薪高于 6 倍以上；
8. 八国集团成员国（美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯）国家级重大科技计划项目负责人或首席科学家。

（十二）近 10 年，在《Nature》《Science》或《Reviews of Modern Physics》杂志上以第一作者或通讯作者发表集成电路相关论文者；

（十三）在全球前 25 大半导体公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十四）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十五）近 10 年，担任过世界 500 强企业及中国 50 强企业总部董事长（或总裁）、首席执行官、首席技术官（技术研发部门第一负责人）、首席设计官（工艺设计部门第一负责人）、首席质量官。

二、第二层次

（一）国际电气和电子工程师协会（IEEE）技术奖获得者；

（二）国家重点联系专家创新人才短期项目、青年项目、新疆西藏项目入选者；国家“万人计划”青年拔尖人才、“新世纪百

千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才；

（三）国家杰出青年基金获得者、中国青年科技奖获得者、中国青年女科学家奖、享受国务院政府特殊津贴人员、全国优秀科技工作者、福建省引才“百人计划”入选者（含团队带头人）、福建省引进台湾高层次人才“百人计划”入选者；

（四）中国机械工业科学技术奖一等奖前 2 位完成人；

（五）近 10 年，获得以下奖项之一者：

1. 国家自然科学奖、技术发明奖二等奖前 3 位完成人，国家科技进步奖二等奖第 1 完成人；

2. 国际发明展览会金奖第 1 完成人，同时是国家科技进步奖二等奖第 2、3 完成人；

3. 中国专利金奖前 3 位专利发明人（设计人）；

4. 全国科技工作者创新创业大赛金奖项目前 3 位完成人；

5. 美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大科学基金杰出青年类资助奖之一者；

6. 全国质量奖个人奖（中国杰出质量人）。

（六）近 10 年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973 计划”项目承担研究任务的项目专家组成员；

2. 原国家“863 计划”领域主题专家组副组长、召集人；

3. 国家科技重大专项专家组副组长、项目（课题）组长，且项目（课题）通过验收；

4. 国家重点研发计划重点专项项目组副组长；

5. 国家自然科学基金重大项目资助的项目主持人、国家自

然科学基金创新研究群体项目的项目负责人、国家重大科研仪器研制项目的项目负责人，且项目已结题；

6. 国家实验室主任、学术委员会主任，国家重点实验室主任、学术委员会主任，国家工程实验室主任、国家工程研究中心主任、国家工程技术研究中心主任、国家能源研发（实验）中心主任、国家级质检中心主任，且年薪高于 6 倍以上；国家制造业创新中心技术委员会副主任，且年薪高于 4 倍以上；

7. 八国集团成员国（美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯）国立研究所所长、副所长、首席研究员或国家实验室主任、副主任、首席研究员；

8. 国际著名学术组织副主席、国际标准化组织（ISO）标样委员会委员；

9. 国际高水平科技期刊（《期刊分区》一、二区）正、副总编（主编）。

（七）在全球前 25 大半导体公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（八）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（九）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球排名 6-10 的公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十）在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、

硅智财（SIP）全球前5大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计5年以上者；

（十一）担任过世界500强企业及中国50强企业总部副董事长、副总裁、副总经理或总部直属一级子公司（大洲级区域部门）主要负责人3年以上者；

（十二）在世界大学排名前200名学校、中国科学院大学获评教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十三）“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十四）取得“985工程”高校和中国科学院大学博士研究生导师资格3年以上且取得正高级专业技术职务者，并从事集成电路相关研究或教学者。

三、第三层次

（一）科技部创新人才推进计划入选者、国家产业技术体系岗位专家、“新世纪百千万人才工程”省级人选、省部级有突出贡献的中青年专家、省（含副省级市）级以上优秀专家、省特支人才“双百计划”、省产业人才高地领军人才、省杰出青年科学基金获得者；

（二）中国机械工业科学技术奖二等奖第1位完成人；

（三）近10年，获得以下奖项之一者：

1. 国家科技进步奖二等奖第2、3位完成人，省科学技术突出贡献奖，省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖一等奖前3位完成人；

2. 国际发明展览会金奖第2、3完成人或国际发明展览会

银奖第 1 完成人，且同时符合以下条件之一：（1）省科技进步奖二等奖前 3 位完成人及以上，（2）取得正高级专业技术资格，（3）取得博士学位；

3. 中国专利优秀奖；省级专利金奖或特等奖、一等奖；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖一等奖前 3 位完成人；

5. 全国科技工作者创新创业大赛银奖项目前 3 位完成人；

6. 国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛特等奖的获奖项目核心团队前 3 位完成人，国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛一等奖的获奖项目核心团队第 1 负责人；

7. 台湾工业总会、商业总会、工商协进会、中小企业总会、工业协进会、电电公会等六大工商团体评选或授予的最高奖项（行业公认奖项）；

8. 中国科学院“百人计划”入选者。

（四）近 5 年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973 计划”项目首席科学家助理、课题组第 1 负责人，且课题通过结题验收；

2. 原国家“863 计划”主题项目或重大项目首席专家，且项目通过验收；

3. 原国家“863 计划”专题组组长、副组长，且专题通过验收；

4. 原国家科技支撑（攻关）计划课题第 1 负责人且课题通过结题验收；

5. 国家科技重大专项专家组成员、项目（课题）第 1 副组长、分课题组长，且项目（课题）通过验收；

6. 国家重点研发计划重点专项任务（或课题）负责人；
7. “国家软科学研究计划”重大项目第 1 负责人且项目通过验收；
8. 科技部国际科技合作计划项目中方项目第 1 负责人且项目通过验收；
9. 国家自然科学基金的重点项目、重大研究计划项目、重点国际（地区）合作研究项目、组织间国际（地区）合作与交流项目、联合基金或优秀青年科学基金项目资助的项目总负责人（不含子项目），且项目通过结题验收；
10. 国家重点实验室、国家工程实验室、国家级企业技术中心、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心、国家能源研发（实验）中心、国家级质检中心前 2 位副主任或工程学术（技术）委员会主任、国家能源研发（实验）中心学术委员会主任，且年薪高于 4 倍以上；
11. 全国专业标准化技术委员会副主任委员；参与国家标准制（修）订排名第 2 位起草人；行业标准制（修）订排名第 1 位起草人；
12. “闽江学者”特聘教授、“桐江学者”特聘教授入选者，并从事集成电路相关研究或教学者；
13. 高等院校国家重点学科带头人、国家精品课程负责人、教育部“211 工程”高校国家重点学科博士生导师，并从事集成电路相关研究或教学者；
14. “工信部制造业单项冠军产品”第 1 研发人员。

（五）在全球前 25 大半导体公司担任二级部门的部门负责人

人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（六）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 7 年以上者；

（七）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球排名 6-10 的公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（八）在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（九）在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十）在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十一）担任过世界 500 强企业及中国 50 强企业总部副董事长、副总裁、副总经理或总部直属一级子公司（大洲级区域部门）主要负责人 1 年以上者；

（十二）在世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学获评副教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十三）在世界大学排名 201-500 名的学校获评教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十四）取得“985 工程”高校和中国科学院大学硕士研究生

导师资格 3 年以上且取得正高级专业技术职务任职资格，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十五）取得博士学位，且近 5 年在期刊分区表中列入大类一区的学术期刊上以第一作者或通讯作者发表 2 篇以上集成电路相关论文者。

四、第四层次

（一）国际电气和电子工程师协会（IEEE）、国际计算机学会（ACM）、国际工程技术学会（IET）、美国物理学会（APS）等国际知名学会高级会员或资深会员；

（二）中国机械工业科学技术奖三等奖第 1 位完成人；

（三）近 5 年，获得以下项目之一者：

1. 省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖二等奖前 3 位完成人、三等奖第 1 位完成人，地市级科学技术奖一等奖前 3 位完成人；

2. 国际发明展览会银奖第 2、3 完成人或国际发明展览会铜奖第 1 完成人，且同时符合以下条件之一：（1）省科技进步奖三等奖前 3 位完成人及以上，（2）取得副高级以上专业技术职务任职资格，（3）取得国家一级职业资格；

3. 省级专利二、三等奖前 3 位专利发明人（设计人），地市级专利金奖或一等奖前 3 位专利发明人或设计人；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖二等奖前 3 位完成人、三等奖第 1 位完成人；

5. 全国科技工作者创新创业大赛铜奖项目前 3 位完成人；

6. 国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛二、三等奖的

获奖项目核心团队的第 1 负责人，获得福建省创新创业大赛总决赛一等奖的获奖项目核心团队的第 1 负责人；

7. 福建青年科技奖；

8. 福建省优秀科技工作者。

（四）近 5 年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973 计划”课题组第 2、3 负责人，且课题通过结题验收；

2. 原国家“863 计划”课题组组长、副组长，子课题负责人，且课题通过结题验收；

3. 原国家科技支撑（攻关）计划课题第 2、3 负责人，且课题通过结题验收；

4. 国家科技重大专项分课题前 2 位副组长，且项目（课题）通过验收；

5. 国家重点研发计划专题负责人；

6. “国家软科学研究计划”面上项目第 1 负责人，且课题通过结题验收；

7. 科技部国际科技合作计划项目中方主要参加人员前 3 位，且完成项目通过验收；

8. 国家自然科学基金年度项目、青年科学基金项目资助的项目第 1 负责人，且项目通过结题验收；

9. 省部级工程实验室主任、学术委员会主任，省部级（重点）实验室主任、学术委员会主任，省部级工程研究中心主任、省级企业技术中心主任、省级制造业创新中心技术委员会主任，且年薪高于 4 倍以上；

10. 全国专业标准化技术委员会分技术委员会主任委员；

11. 国家级服务型制造示范企业、国家级服务型制造示范项目实施主体企业总经理，国家级服务型制造示范平台负责人、省级服务型制造公共服务平台负责人，省级中小企业公共服务示范平台运营负责人、省级小微企业创新创业示范基地运营负责人，且年薪高于 4 倍以上；

12. 教育部“211 工程”高校国家重点学科教授或研究员，并从事集成电路相关研究或教学者；

13. 福建省高校新世纪优秀人才计划入选者，并从事集成电路相关研究或教学者；

14. “省级制造业单项冠军产品”第 1 研发人员。

（五）在全球前 25 大半导体公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（六）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 10 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（七）在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（八）在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（九）在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司

担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（十）担任过世界 500 强企业或中国 50 强总部一级部门负责人或与之级别相当的专业技术人员、总部直属一级子公司（大洲级区域部门）副总或与之级别相当的专业技术人员等职务 3 年以上者；

（十一）取得“985 工程”高校和中国科学院大学硕士研究生导师资格 3 年以上且取得副高级专业技术职务任职资格，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十二）博士后出站留（来）晋江创业或工作者；

（十三）晋江市博士后科研工作站进站博士后；

（十四）取得世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学的博士学位，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作；

（十五）取得正高级专业技术职务任职资格者。

五、第五层次

（一）近 5 年，获得以下奖项之一者：

1. 省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖三等奖第 2、3 位完成人，地市级科学技术奖二等奖前 2 位完成人、三等奖第 1 位完成人；

2. 国际发明展览会铜奖第 2、3 完成人，且同时符合以下条件之一：（1）地市级科技进步奖三等奖前 3 位完成人及以上，（2）取得副高级以上专业技术任职资格，（3）取得国家一级以上职业资格；

3. 地市级专利银奖、优秀奖或二、三等奖前 3 位专利发明人或设计人；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖三等奖第 2 位完成人；

5. 福建省创新创业大赛总决赛二等奖的获奖项目核心团队的第 1 负责人。

(二) 近 5 年，担任以下职务之一者：

1. 省部级（重点）实验室、学术委员会、省部级工程实验室、省部级工程研究中心、省级企业技术中心、省级制造业创新中心技术委员会副主任，且年薪高于 2 倍以上；

2. 全国专业标准化技术委员会分技术委员会副主任委员；

3. 担任国家级服务型制造示范企业、国家级服务型制造示范项目实施主体企业、省级服务型制造示范企业总经理，省级服务型制造示范平台负责人，且年薪高于 2 倍以上；

4. 省级学科（教学）、专业带头人，并从事集成电路相关研究或教学者；省级精品在线开放课程、共享课程负责人且项目通过验收，并从事集成电路相关研究或教学者。

(三) 在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 10 大公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(四) 在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（五）在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（六）在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（七）取得国家一级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家最高等级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 2 倍以上；

（八）取得博士学位者；

（九）取得世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学的硕士学位，所学专业学科门类为理学、工学或相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的硕士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作；

（十）取得副高级专业技术职务任职资格者。

六、第六层次

（一）在国家鼓励的集成电路企业担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应科研技术职务以上累计 5 年以上者；

（二）取得国家一级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家最高等级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 1 倍以上；

（三）取得硕士学位者；

（四）取得世界大学排名前 500 名学校的学士学位，所学专

业学科门类为理学、工学，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作；

（五）取得“985 工程”高校、中国科学院大学、台湾大学、台湾清华大学、台湾阳明交通大学、台湾成功大学、台湾中央大学、台湾中山大学、香港大学、香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学、香港浸会大学、香港理工大学、澳门大学等院校的理学、工学学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作；

（六）取得相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作。

七、第七层次

（一）取得国家二级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家二级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 1.5 倍以上；

（二）取得国家相关部委发布的“双一流”建设高校及台湾中正大学、台湾中兴大学、台湾科技大学、台湾元智大学、台北科技大学、台湾阳明大学、台湾长庚大学等院校理学、工学学位或“双一流”建设学科名单所属学科的理学、工学学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作；

（三）在我市集成电路企业从事集成电路科研、技术、工程相关工作累计 5 年以上，且符合以下条件之一者：

1. 取得全日制学士学位，所学专业学科门类为理学、工学；
2. 现担任我市集成电路企业技术研发、工程部门功能主管或其他相应职务以上。

说明

一、本标准中所有奖项、荣誉、职称等的获得都必须源于集成电路领域的成就与贡献；

二、国际电气和电子工程师协会（IEEE）奖章包括：

IEEE Medal of Honor

IEEE Alexander Graham Bell Medal

IEEE Edison Medal

IEEE James H. Mulligan, Jr. Education Medal

IEEE Medal for Environmental and Safety Technologies

IEEE Founders Medal

IEEE Richard W. Hamming Medal

IEEE Medal for Innovations in Healthcare Technology

IEEE Jack S. Kilby Signal Processing Medal

IEEE/Royal Society of Edinburgh (RSE) Wolfson James Clerk
Maxwell Award

IEEE Jun-ichi Nishizawa Medal

IEEE Robert N. Noyce Medal

IEEE Dennis J. Picard Medal for Radar Technologies and
Applications

IEEE Medal in Power Engineering

IEEE Simon Ramo Medal

IEEE John von Neumann Medal

IEEE Honorary Membership

三、国际电气和电子工程师协会（IEEE）技术奖项包括：

IEEE Biomedical Engineering Award

IEEE Cleo Brunetti Award

IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology
Award

IEEE Control Systems Award

IEEE Electromagnetics Award

IEEE James L. Flanagan Speech and Audio Processing Award

IEEE Fourier Award for Signal Processing

IEEE Andrew S. Grove Award

IEEE Herman Halperin Electric Transmission and Distribution
Award

IEEE Masaru Ibuka Consumer Electronics Award

IEEE Internet Award

IEEE Reynold B. Johnson Information Storage Systems Award

IEEE Richard Harold Kaufmann Award

IEEE Joseph F. Keithley Award in Instrumentation and
Measurement

IEEE Gustav Robert Kirchhoff Award

IEEE Leon K. Kirchmayer Graduate Teaching Award

IEEE Koji Kobayashi Computers and Communications Award

IEEE William E. Newell Power Electronics Award

IEEE Daniel E. Noble Award for Emerging Technologies

IEEE Donald O. Pederson Award in Solid-State Circuits

IEEE Frederik Philips Award

IEEE Photonics Award

IEEE Emanuel R. Piore Award

IEEE Judith A. Resnik Award

IEEE Robotics and Automation Award

IEEE Frank Rosenblatt Award

IEEE David Sarnoff Award

IEEE Marie Sklodowska-Curie Award

IEEE Innovation in Societal Infrastructure Award

IEEE Charles Proteus Steinmetz Award

IEEE Eric E. Sumner Award

IEEE Nikola Tesla Award

IEEE Kiyo Tomiyasu Award

IEEE Transportation Technologies Award

IEEE Frederik Philips Award

四、“世界 500 强”即美国《财富》杂志每年评选的“全球最大 500 家公司”，“中国 50 强企业”即由中国与全球化智库(CCG)研究编写、社科院社科文献出版社出版的企业国际化蓝皮书《中

国企业全球化报告》中综合评选出的“中国企业全球化 50 强”；

五、国际著名学术组织包括：电气与电子工程师学会（美国）—IEEE(The Institute of Electrical And Electronics Engineers)、电气工程师学会（英国）—IEE（ The Institutions of Electrical Engineers ）、国际工程技术学会—IET（ The Institution of Engineering and Technology ）、美国物理学会—APS（ American Physical Society ）、美国计算机协会—ACM（ Association for Computing Machinery ）；

六、全球前 25 大半导体公司，集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 10 大公司和大陆或台湾前 10 大公司，及集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司名称参照国际级研究机构IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC、IHS或中国半导体行业协会发布的最近年度企业排名。在此类公司总部任职人员，按照本标准认定人才类别；在此类公司的分公司、全资子公司、控股子公司或地区总部任职人员按照本标准降低一级认定人才类别；

七、国际发明展览会包括：法国巴黎国际发明展览会、欧盟斯特拉斯堡国际发明展览会、德国纽伦堡国际发明展览会；

八、前文“从事职业资格所在领域工作相应年限以上”，均指取得相应职业资格证书并完成注册、登记等执业准入要求后的工作年限；

九、职业资格参照国家人社部网站发布的国家职业资格目录清单；

十、世界大学排名参照英国泰晤士高等教育发布的最近年度高等教育世界大学排名；

十一、期刊分区参照中国科学院发布的论文发表当年度期刊分区情况；

十二、前文“年薪高于相应倍数以上”，如无特别说明，均指我市用人单位连续 1 年支付年薪高于我市上一年度城镇单位在岗职工平均工资相应倍数以上；

十三、专业学科门类认定参考国家相关部委发布的最新版《学位授予和人才培养学科目录》及相关规定；

十四、在站博士后实际服务单位与省人社厅开具的介绍信单位不符的，需提供所在市委组织部或人社局出具的相关事实函件；

十五、“985 工程”高校名单（39 所）：北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、中南大学、国防科学技术大学、中山大学、华南理工大学、四川

大学、电子科技大学、重庆大学、西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、兰州大学；

十六、支持(筹备)建设示范性微电子学院的高校名单、“211工程”高校名单、“双一流”建设高校及学科名单、国家鼓励的集成电路企业名单以相关部门发文公布的最新版为准；

十七、本标准中取得相关国家部委支持(筹备)建设示范性微电子学院的学士学位或国家相关部委发布的“双一流”建设高校学位或“双一流”建设学科名单所属学科学位的,均应为国家部委相关政策颁布实施后取得的；

十八、本标准中的“以上”包括本级(本数)；

十九、认定条款中“近5年、近10年等年限”，以申报时间为起始时间，往前推算5年或10年。如申报时间为2025年5月20日,则近5年则为2020年5月21日至2025年5月20日；

二十、本标准中通过个人荣誉、工作年限、学位证书等内容认定为我市集成电路产业优秀人才的,相关佐证不可于技术研发人才积分评定中重复使用；

二十一、本标准自公布之日起开始实施,2025年1月30日起至公布之日期间参照执行。

附件 3

晋江市集成电路产业技术研发人才 积分评定办法

一、总则

（一）为贯彻落实中央、省委关于深化人才体制机制改革的实施意见和泉州市人才“港湾计划”有关精神，深入实施晋江市“人才强市”战略，加快聚集集成电路产业人才，优化集成电路产业人才评价体系，根据我市集成电路产业实际，特制定本办法。

（二）晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定工作在福建省集成电路产业园区建设筹备工作组（以下简称“集成电路筹备组”）领导下，由集成电路筹备组人才科技组负责组织实施。

（三）集成电路产业技术研发人才积分评定工作应遵循客观公正、公开透明、科学评价、程序规范、高效便民的原则。

二、适用对象

本实施办法适用于在我市注册且上一年度主营业务收入 1 亿元以下（含 1 亿元，人民币）的新一代信息技术企业技术研发人才（主营业务收入以税务申报金额为准），其中经济效益、投融资金额、人才汇聚及社会效益中党建部分仅适用于企业股东，经济效益、投融资金额要求适用企业股东签订劳动合同并占股超过 10%（含 10%）且当年度在企业连续缴纳社会保险或个税。

三、积分办法

本办法采用指标量化方式，计分项目由基础分、贡献分、

资历分和一票否决项四部分组成。基础分以优秀人才初始获批认定的人才层次为加分依据，属于固定分值，不受后续人才层次晋升而变化；贡献分由人才在促进企业、行业和社会发展中取得的各项业绩组成；资历分由人才在晋服务年限和人才家庭融入晋江程度组成，其中人才在晋服务年限仅限于新一代信息技术企业；一票否决主要是涉及违法、违纪、重大失信等行为，人才出现一票否决情形的，人才个人取消积分资格，企业出现一票否决情形的，企业股东取消积分资格。积分每年度核算一次，根据人才当年度内获得的贡献分、资历分累加后，再加上基础分计算得出总分值，根据总分值对应的人才层次给予人才晋升层次。人才通过积分评定晋升人才层次，基础分不随人才层次变更而变更，加分项不重复计算。积分项目和分值详见附件。

四、积分申请和审核

（一）用人单位每年 12 月份统一为人才提出积分申请，按要求提交相关证明材料。

（二）用人单位为人才进行积分申请，并负责审核申请人提交材料的真实性，所有材料需加盖用人单位公章，如提供复印件必要时需提供原件备查。

（三）同一证明材料（含个人荣誉、工作年限、学位证书等）不可重复应用于人才层次认定与人才积分评定。

（四）积分评定程序分为：1. 审核，由集成电路筹备组人才科技组组织对申报材料进行核定并提出拟调整人才层次意见；2. 公示，积分结果及调整后的人才层次在集成电路通八达

筹备组及申报企业公示 5 个工作日；3. 发布公告，经公示无异议后，发布人才层次变更公告。

（五）申请人对人才积分审核结果有异议的，可在公示之日起 5 个工作日内申请复核；受理部门应当自收到复核申请之日起 5 个工作日内完成核查，并将复核结果告知申请人。

五、积分运用

人才凭所获积分认定为对应分值层次的优秀人才，可依据本意见享受相应的人才优惠政策。

六、监督检查

（一）申请人或用人单位做出虚假承诺、伪造或提供虚假证明资料的，一经部门审查发现，不予纳入人才积分体系，且自造假行为被发现之日起，5 年内不接受人才积分评定，并记入本市社会征信系统。构成犯罪的，依法追究相关法律责任。

（二）对人才积分审核有异议的，可向受理部门申诉或提出异议，由相关部门对异议情况进行调查核实。

七、附则

（一）本办法自公布之日起实施，2025 年 1 月 30 日起至公布之日期间参照执行。

（二）本办法由泉州半导体高新技术产业园区管委会晋江分园区办事处负责解释。

附件：晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定表

附件

晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定表

类别	积分项目	积分标准	证明材料
基础分	集成电路产业 技术人才	对照《晋江市集成电路产业优秀人才认定标准》，符合相应层次认定条件的： 第一层次人才得 6000 分； 第二层次人才得 4000 分； 第三层次人才得 2000 分； 第四层次人才得 1000 分； 第五层次人才得 500 分； 第六层次人才得 200 分； 第七层次人才得 100 分； 非优秀人才得 0 分。	
贡献分	经济效益	企业年度主营收入首次突破 500 万元（人民币，下同），加 50 分； 此后，企业年度主营收入较前一年每新增 1000 万元，再追加 50 分； 企业年度主营收入以企业上一年度税务申报金额为准。	
	投融资金额	（1）企业累计吸引投资机构投资达到 500 万元（人民币，下同），加 100 分。此后，每新增吸引投资机构投资满 1000 万元，再追加 50 分； （2）个人累计投资资金达到 100 万元，加 100 分。此后，个人每新增投资满 100 万元，再追加 50 分； 该项累计加分上限 1000 分。 以投融资实际到账金额为准。	验资报告、股权转让协议、出资证明、银行电子回单、工资发放凭证等。
	创新成果	（1）以第一发明人身份申请并获授权集成电路及相关领域发明专利每件加 50 分； （2）以第二发明人身份申请并获授权集成电路及相关领域发明专利每件加 20 分； 该项累计加分上限 500 分。	发明专利证书副本或国家知识产权局官网所查询到的公告。

类别	积分项目		积分标准	证明材料
贡献分	人才汇聚		(1) 企业每新引进 1 名集成电路及相关领域博士研究生员工，加 50 分； (2) 企业每新引进 1 名集成电路及相关领域硕士研究生员工，加 20 分； 该项累计加分上限 500 分。（引进人员需常年在晋工作）	劳动合同/社保记录/员工学历、学位证书复印件等。
	社会效益	荣誉	(1) 个人获得各级劳模、道德模范、先进工作者、荣誉市民、见义勇为奖及其他同等荣誉，其中：县处级的每次得 20 分，地厅级的每次得 30 分，省部级的每次得 50 分，国家级的每次得 100 分； (2) 个人入选“两代表一委员”的，其中：县处级的每次得 20 分，地厅级的每次得 30 分，省部级的每次得 50 分，国家级的每次得 100 分； (3) 在晋江市范围内有参与无偿献血、志愿服务、慈善捐款等活动，每项可加 2 分，每年累计加分上限 10 分。	荣誉证书、献血证书、志愿工时证明、获奖证书、慈善捐赠等。
		党建	企业建立党组织机构的，加 50 分； 每发展一名企业党员，加 20 分。 该项累计加分上限 150 分。	
资历分	服务年限		在晋服务年限，每在晋工作满一年加 20 分，累计加分上限 200 分。	社保缴交记录。
	在地加分项		在晋购买住房加 20 分，配偶在晋工作加 20 分，子女在晋就学加 20 分。	相关佐证材料。
一票否决项			(1) 提供虚假材料申报的； (2) 个人存在刑事犯罪、违反党纪、重大失信行为的，违反意识形态十类情形的； (3) 所在企业存在偷税、逃税、抗税、骗税行为受到税务部门处罚的，存在违法经营行为受到处罚的； (4) 企业汇算清缴年度发生严重失信行为，较大及以上火灾事故、重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为； (5) 所在企业及个人存在涉黑涉恶情形的； (6) 其它不符合人才政策的情形。	由宣传、公安、法院、税务、市场监管、消防大队等部门联合核查征信情况并提供相应记录材料。

市有关单位：组织部、教育局、科学技术局、工业和信息化局、卫生健康局、泉州市医疗保障局晋江分局、城建集团、集成电路筹备组。

抄送：市委办、人大办、政协办、纪委办。

晋江市人民政府办公室

2025年6月26日印发
